

证券代码：688279

证券简称：峰昭科技

峰昭科技（深圳）股份有限公司
投资者关系活动记录表

2022年11月

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 网络会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	参与业绩说明会的广大投资者
时间	2022年11月
地点	上海证券报·中国证券网路演中心（网址： https://roadshow.cnstock.com/ ）
上市公司接待 人员姓名	董事长、总经理：BI LEI 财务总监：林晶晶 董事会秘书：黄丹红
投资者关系活动 主要内容	<p>公司2022年第三季度报告于2022年10月28日依法披露后，于2022年11月16日在上海证券报·中国证券网路演中心平台以网络互动方式召开了2022年第三季度业绩说明会，与投资者做了进一步交流。相关交流内容汇总如下：</p> <p>1、 请问，电机厂商对我们定制芯片的比例，和我们标准化产品的比例，大约各自占收入比重如何？电机厂商是否担心我们更多的掌握了电机控制算法而侵蚀他们的利润空间？</p> <p>答：您好，公司专注于电机驱动控制芯片的研发，基于在芯片技术、电机驱动架构算法、电机技术三个领域的深厚技术积累，公司拥有向下游客户提供包括电机驱动控制芯片、电机驱动控制整体方案、电机系统优化在内的系统级服务的能力，全方位的服务增强了客户的粘性，也增强了公司的产品竞争力。感谢您的关注，谢谢！</p>

2、 您好！相比去年，请介绍下营收减少，存货增加的情况。

答：您好，受新冠疫情反复以及俄乌战争爆发等影响，宏观经济发展显著放缓，公司整体营收较上年同期有所下降；公司采用行业典型的 Fabless 经营模式，芯片生产所需经历的晶圆制造、封装、测试等生产工序均由外部厂商完成，公司自采购获取晶圆原材料入库后到封装测试等委外加工至芯片产品完工，需要一定周期，公司综合考虑产业环境、市场预测及销售需求等因素进行备货。具体情况请关注公司定期报告，感谢您的关注，谢谢！

3、 请问公司产品进入车企的进展如何？主要为车企提供哪一类芯片？每台车需要公司产品的数量有多少？

答：您好，公司持续加大汽车电子领域的研发力度，公司车规级产品通过 AEC-Q100 车规认证。公司持续推进汽车电子领域的市场拓展，由于汽车电子领域对可靠性验证等要求高，市场导入周期将较长，公司将持续为汽车电子下游客户提供全方位的系统级技术支持服务，稳步推进产品在新兴领域的应用。感谢您对公司的关注，谢谢！

4、 中报公司有提到 14 个在研新产品，目前有多少个产品变现应用？新产品利润率如何？一般新产品面市后两年，利润率是否会下降？

答：您好，公司半年报已披露在研项目情况，公司始终专注于高性能电机驱动控制芯片及控制系统的研发，保障研发项目的进展，保持技术竞争优势，在研项目情况请持续关注公司定期报告，感谢您对公司的关注，谢谢！

5、 请问公司如何看待服务器市场的未来增长空间，是否会成为我们近几年增长最快的下游领域？这部分客户是终端服务器厂商还是风扇厂，是否需要服务器厂商认证我们的产品，客户选择我们是因为价格优势还是性能？

答：您好，散热风扇（应用于服务器等）是公司产品的下游应用领域之一，公司产品凭借性能优势和系统级服务拓展下游市场，一方面，公司始终专注于高性能电机驱动控制芯片及控制系统的研发，保持技术竞争优势；另一方面，公司持续

在应用领域和市场开拓上发力,积极拓展新兴应用领域和市场,为公司长期发展、未来业绩增长打下扎实的根基。感谢您的关注,谢谢!

6、电机芯片行业的技术更新情况如何?目前有没有其他公司在研产品技术强过峰昭的产品技术?

答:您好,公司的核心技术涵盖高性能电机驱动控制芯片设计技术、电机驱动架构算法技术及电机技术三个技术领域,公司持续在上述技术领域进行研发和攻关,巩固和提升技术竞争优势,感谢您的关注,谢谢!

7、据我观察,这个季度的归母扣非净利率有一定程度的下滑,是因为什么原因呢?与同行业的其余MCU公司相比,例如中颖以及兆易,你们的归母扣非净利率水平很高,请问是什么原因呢?业绩已经连续两个季度连续下滑,环比形势也不妙,对于此,除去宏观环境的影响,公司会做出哪些努力?对第四季度以及明年有什么样的预期?

答:您好,公司为及时满足下游不同领域产品应用需求,保障电机驱动控制芯片设计和技术水平处于行业前列及达到国际水平,持续加强研发投入、市场推广投入力度,报告期费用较上年同期上升。公司电机主控芯片MCU采用“双核”结构,其中负责实现电机控制的专用内核ME为公司自主研发、独立设计,具有完全自主知识产权,不需要支付IP授权费用。公司从研发、市场开拓、客户支持等方面采取措施积极应对国际形势和新冠疫情对公司业务发展的影响,一方面,公司始终专注于高性能电机驱动控制芯片及控制系统的研发,保障研发项目的进展,保持技术竞争优势;另一方面,公司持续在应用领域和市场开拓上发力,积极拓展新兴应用领域和市场,为公司长期发展、未来业绩增长打下扎实的根基。公司第四季度及明年业绩情况请留意公司的定期报告,感谢您对公司的关注,谢谢!